1. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HDI |  | Es una mejora al formato de datos RS-274-D como una versión extendida. |
|  |  |  |
| Revestimiento conductor de la superficie |  | Proporciona la base para crear el patrón de circuito. |
|  |  |  |
| VIA |  | Es una conexión eléctrica entre capas en un circuito electrónico físico que atraviesa el plano de una o más capas adyacentes. |
|  |  |  |
| RS-274X |  | Abreviatura utilizada para referirse a PCB de interconexión de alta densidad |

1. Enumere tres características básicas de las placas de circuito impreso de interconexión de alta densidad.

1. Mayor densidad de cableado por unidad de área que las PCB convencionales.

2. Tienen líneas y espacios más finos.

3. Tienen vías más pequeñas, pads de captura y una densidad de pads de conexión muy alta.

1. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Los pines de la fuente de alimentación se deben desacoplar directamente del plano de tierra mediante el uso de lo más cerca posible de los pines de alimentación del circuito integrado.

En general, frecuencias superiores a 1GHz son consideradas altas frecuencias.

Los PCBs de una capa son fabricados de un sola capa de .

Las PCB con respaldo de aluminio : Aluminum backed PCBs, se componen de un refuerzo de una capa dieléctrica altamente conductora térmicamente y una capa de circuito estándar.

Las PCB rigid-flex, combinan lo de las placas rígidas y flexibles integradas juntas.

1. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Floor plan |  | Se refiere a la leyenda blanca en el PCB que identifica los componentes, puntos de prueba |
|  |  |  |
| Diseño Esquemático |  | Dibujo que indica la ubicación general de los componentes en el PCB. |
|  |  |  |
| DRC |  | Diagrama de un circuito electrónico en el software CAD. |
|  |  |  |
| Serigrafía (Silkscreen) |  | Es una función de software CAD que verifica si la PCB enrutada cumple con las reglas de diseño. |

1. Enumere un mínimo de 5 pasos básicos del proceso de fabricación de PCB.

1. Film generation

2. Perforación

3. Proceso de grabado (Etching)

4. Máscara de soldadura

5. Serigrafía

1. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Mantener las masas digitales y analógicas porque los picos de tensión y los de corriente desde circuitos pueden generar ruido de interferencia en los circuitos .

Al ubicar los componenetes, las distancias y evitar ángulos de grados.

Los fabricantes utilizan un para obtener una imagen del PCB.

Las señales sensibles deben ser de las fuentes de ruido con planos y debe realizarse un control de impedancia.